|  |  |
| --- | --- |
| **推動模式** |  □**客製化諮詢** □**加值研習** (□單一企業 □2家(含)以上企業) □**技術研討** |
| **技術主題** | 請描述本專案技術範疇與提案主題 | **培訓經費** | ○○○○○○元(委辦款及企業出資總計) |
| **申請單位** |  |
| **執行期間** | 113/○○/○○-113/○○/○○  | **時數** |  | **預計人數** |  |
| **培訓地點** |  |
| **需求單位(企業)** |  |
| **參訓對象** | 說明適訓職員條件，例如擔任職務、年資、教育背景或應具備的基礎知識。 |
| **前瞻範疇** | 高 階 設 計：□電路設計 □系統 □記憶體 □感測高階製程與材料：□先進元件 □製程整合/特性分析 □先進設備/關鍵設備零組件□材料高 階 封 裝：□先進封裝 □深度感測 □人工智慧 □大數據分析 □技術整合型封裝□其他:請說明 |
| **技術/專案問題與****目標概述** | 填寫說明:本規劃係因應何種業界實務需求或何種新興應用趨勢。說明業界對本規劃內容有明確需求，或可支援某特定技術之發展。* 專案問題 (規格定義、製程選定、架構選擇、電路設計、設備升級…)
* 專案目標
* 專案概要
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **技術名稱** | **技術大綱****(實務部分須說明設計及使用設備名稱)** | **授課專家** | **時數** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 合 計 |  |
| **專家(顧問/講師)資料** |
| **授課師資** | **學/業** | **現職** | **最高學歷/經歷** | **專長** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **預期成果/效益評估** |
| 填寫說明：請依合理性、適切性及可達成度審慎自評，請以文字說並填答質量化指標，以利委員審查。說明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **量****化****指****標** | **人力資源** | \*擇1填列企業人才訓練成本減少　 元、上手時間縮短\_\_\_\_其他：請說明 |
| **工作效能** | \*擇1填列人均產值上升\_\_\_\_%、工作成本下降\_\_\_\_%、作業良率提升\_\_\_\_%、專案開發時間減少\_\_\_\_%其他：請說明 |
| **質****化****指****標** | **促進實務****工作應用** | 填寫說明：請說明預期職員結訓後具備的專業技能，並評估對產業或區域發展之助益。 |

　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **專家(顧問)****簽名/日期** |  | **企業專案負責人****簽名/日期** |  |

* + **同意加入公私(產學)共育國內外高階人才計畫之國際產學交流聯盟會員。**
	+ **已屬公私(產學)共育國內外高階人才計畫之國際產學交流聯盟會員。**